

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2025-031

希荻微电子集团股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称“香港希荻微”）和二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称“HMI”）。

● 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。

- 被担保人未提供反担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2025 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况

（一）情况概述

根据公司 2025 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司预计在 2025 年度向银行申请合计不超过 10 亿元人民币或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、项目贷款（含并购贷款等）、抵押贷款、流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、银行保函、国内外贸易融资等综合授信业务。上述授信额度包括

新增授信及原有授信的展期或续约，也包括已签订尚在合同有效期内的授信期超过 12 个月的长期授信。

公司在上述授信额度内为子公司提供连带责任担保，担保额度预计不超过人民币 6 亿元或等额 6 亿元人民币的美元。

上述授信和担保事项的授权有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等，并在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

上述授信及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际授信及担保额度最终以银行等金融机构最后审批的授信及担保额度为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资及担保期限以实际签署的合同为准。

（二）决策程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

（一）香港希荻微

公司名称	Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.
成立时间	2013 年 10 月 4 日
董事	TAO HAI（陶海）
股本情况	已发行股份数为 90,001,300 股普通股（注）
住所	8/F., Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Central, Hong Kong
主营业务及与希荻微主营业务的关系	集成电路模拟芯片的物流、采购和销售等，系希荻微主营业务的组成部分
股权结构	希荻微持股 100%

	2023 年 12 月 31 日/2023 年 度（万元人民币）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（万元人民币）
资产总额	97,434.04	100,874.26
负债总额	49,318.37	39,360.28
其中，银行贷款	32.61	2,222.71
流动负债总额	49,253.13	37,477.56
资产负债率	50.62%	39.02%
净资产	48,115.67	61,513.98
营业收入	45,011.93	53,654.19
净利润	-3,407.95	-9,449.41
扣除非经常性损益后 的净利润	-3,514.69	-10,088.53
是否存在影响被担保 人偿债能力的重大或 有事项	否	

注：1.公司此前对香港希荻微的增资 3,000 万美元（详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-015））已支付完毕全部增资款，但香港希荻微尚未办理股本变更登记，香港希荻微目前股本仍登记为 60,001,300 股。

2.上述香港希荻微财务数据为香港希荻微合并范围数据。

（二）HMI

公司名称	Halo Microelectronics International Corporation
成立时间	2019 年 6 月 11 日
董事	TAO HAI（陶海）、唐娅
股本情况	已发行股份数为 1,000 股普通股，每股面值 0.00001 美元，实收资本为 250,000 美元
住所	1735 N FIRST STREET, STE 312, SAN JOSE, CA 95112
主营业务及与希荻微 主营业务的关系	集成电路模拟芯片的技术支持、客户支持、市场推广等， 系希荻微主营业务的组成部分

股权结构	香港希荻微持股 100%	
	2023 年 12 月 31 日/2023 年 度（万元人民币）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（万元人民币）
资产总额	57,061.40	65,808.28
负债总额	50,085.87	56,168.27
其中，银行贷款	25.58	2,220.87
流动负债总额	50,046.51	54,348.85
资产负债率	87.78%	85.35%
净资产	6,975.53	9,640.01
营业收入	16,020.11	20,209.54
净利润	3,459.47	-1,698.82
扣除非经常性损益后 的净利润	3,356.00	-2,334.60
是否存在影响被担保 人偿债能力的重大或 有事项	否	

注：上述 HMI 财务数据为 HMI 合并范围数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、担保的必要性

上述担保为满足子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展。公司对被担保人享有绝对的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计的 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度及担保预计符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

综上，董事会同意《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 6 亿元人民币，全部为公司对子公司的担保（不含本次的担保，且全部为已批准但尚未使用的担保额度）。上述金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 38.25%、33.14%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日